

证券代码：430568

证券简称：光莆电子

主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请授信额度及提供抵押基本情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司经营持续发展，保证经营目标的实现，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限 3 年，用途为贷款、承兑商业汇票、出具保函等业务，公司将位于厦门市翔安区民安大道 1802 号、1804 号、1806 号、1808 号、1810 号的不动产权向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行提供最高额抵押担保。

拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，用途为贷款、票据贴现、商业承兑汇票等业务，该综合授信不涉及抵押、保证等担保。

上述拟申请综合授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。

二、审议和表决情况

2016年11月12日，公司召开了第二届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信事项经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016年11月14日